

News Release



2008年7月8日

BASF とエボニック、高度な CMP スラリーを共同開発

- セリアベースのスラリーによって、高いコスト効果と品質を実現し、将来の課題に対応

エボニック インダストリーズ AG と BASF (本社:ドイツ ルートヴィヒスハーフェン) は、コンピュータチップの加工用のセリアベーススラリーを共同で開発することに合意しました。BASF の強みである化学的な専門知識やグローバルなマーケティング・販売能力と、エボニックの強みであるナノマテリアル分野での主導的地位を活用します。この合意によって開発されるスラリーは、2009年に商用化される予定です。

セリアなどのナノスケール材料を含有するスラリーは、ウェハー表面の酸化膜を研磨し、表面を平坦化するために使用されており、このプロセスは、化学的機械的研磨 (CMP) として知られています。集積回路 (IC) を加工する上で最も重要な処理工程は、STI (浅溝型素子分離) と ILD (層間絶縁膜) であり、STI は、CMP スラリーを必要とする用途の中で、最も急成長している分野の一つです。

エボニックの無機材料ビジネスユニットの技術ソリューション担当バイスプレジデント、ヨルダニス・サヴォプロスは、次のように述べています。

「回路の高密度化に伴い、CMP プロセスの要件は、IC を加工する上で重要なものとなっています。今回のプロジェクトによって、エボニックと BASF は最先端の CMP 技術を実現し続け、IC 業界に次世代のソリューションと材料をお届けできると考えています」。

お問い合わせ:
BASF ジャパン株式会社
大倉真紀
TEL: 03-3238-2341
FAX: 03-3238-2514
maki.okura@basf.com

BASF ジャパン株式会社
コーポレート・コミュニケーションズ
住所: 〒102-8570
東京都千代田区紀尾井町 3-3
TEL: 03-3238-2341
FAX: 03-3238-2514
<http://www.japan.basf.com>

BASF 電子材料グローバルビジネス・ユニットの CMP 部門プレジデント、クレメンス・マタウアーは次のように述べています。

「IC 製品を開発する上で、化学は重要な役割を果たします。化学分野での幅広い実績および IC 業界での長年の経験を持つ BASF と、研磨粒子の専門知識を持つエボニックが力を合わせることで、私たちは高度なソリューションを提供し、厳しさを増す市場の要件に対応できます」。

エボニックは、重要な基礎成分である酸化セリウムの各種グレードと、これら粒子の配合に関するノウハウを提供することで、共同開発に貢献します。

BASF は、ヨーロッパとアジアにある先端技術の研究所により支えられた CMP スラリーの配合、生産、応用に関するノウハウで貢献します。

■エボニックについて

エボニック インダストリーズは、「化学」、「エネルギー」、「不動産」の 3 つの分野で事業を展開する、ドイツのクリエイティブな産業グループです。エボニックは、スペシャリティケミカルのグローバルリーダーであり、石炭や再生可能エネルギーによる発電のエキスパートであると同時に、ドイツ最大の個人向け不動産会社のひとつです。当社の強みは、創造性、専門性、継続した再生力・信頼性です。エボニックは、世界 100 カ国以上で事業を展開しています。2007 年度には、約 4 万 3,000 人の従業員を擁し、約 144 億ユーロの売上高と 13 億ユーロの EBIT(利息・税金控除前利益)を計上しました。エボニックのインターネットホームページアドレスは www.evonik.com です。

■BASFについて

BASF(ビーエーエスエフ)は、「ザ・ケミカル・カンパニー(The Chemical Company)」を標語に掲げる世界の化学業界のリーディングカンパニーです。製品ポートフォリオは、石油・ガスから化学品、プラスチック製品、高機能製品、農業関連製品、ファインケミカル製品と多岐にわたります。信頼に応えるパートナー企業として、あらゆる業界のお客様のさらなる成功をサポートしています。BASFは、高付加価値製品と高度なソリューションの提供を通じ、温暖化防止やエネルギー効率の向上、栄養改善、モビリティ向上などの世界的な課題の解決に重要な役割を果たしています。従業員数は9万5,000人超、2007年には約580億ユーロの売上高を計上いたしました。BASF のホームページアドレスは、www.basf.com、BASF ジャパンのホームページアドレスは、www.japan.basf.comです。